STANDARDLAGENAUFBAU HDI

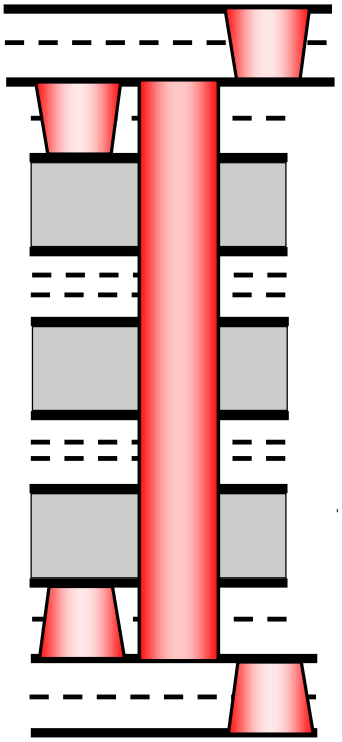
HDI10_2+6(8b)+2_1,50_35

10 - Lagen

Kerne: 0,25 mm Cu 35/35 µm

WE-Artikel Nr.:		**2 + 6(8B) + 2**
KUNDE:		

WÜRTH ELEKTRONIK

LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG
KUNDE	WE					[µm]	[µm]
1	TOP/VS		Folie	12 µm	1)	**12**	
					1 x 1080	**60**	
2	VSK1		Folie	9 µm		**30**	
					1 x 1080	**60**	
3	2			35 µm		**33**	
			0,250 mm			**250**	
4	3			35 µm		**33**	
					2 x 1080	**124**	
5	4			35 µm		**33**	
			0,250 mm			**250**	
6	5			35 µm		**33**	
					2 x 1080	**124**	
7	6			35 µm		**33**	
			0,250 mm			**250**	
8	7			35 µm		**33**	
					1 x 1080	**60**	
9	RSK1		Folie	9 µm		**30**	
					1 x 1080	**60**	
10	BOT/RS		Folie	12 µm	1)	**12**	

1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm

Gesamtdicke Material: 1520

Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)

MATERIALDICKE:	**1,50**	+/-	0,13	mm			Datum:	Bearbeiter:
DICKE über galv. Endoberfläche	1,59	+/-	0,16	mm				
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,65	+/-	0,18	mm				
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:			

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision		
27.03.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	04.05.2006	R.Schönholz	00	Seite:	15+